

描述 / Descriptions

TO-251 塑封封装 N 沟道 MOS 场效应管。N-CHANNEL MOSFET in a TO-251 Plastic Package.

特征 / Features

$R_{DS(on)}$ 小, 门电荷低, C_{rss} 小, 开关速度快。

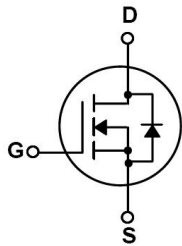
Low $R_{DS(on)}$, low gate charge, low C_{rss} , fast speed switching.

用途 / Applications

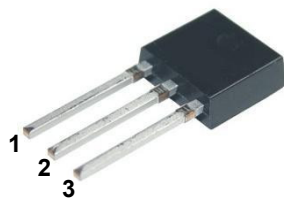
用于低压电路如: 汽车电路、DC/DC 转换、便携式产品的电源高效转换。

Suited for low voltage applications such as automotive, DC/DC Converters, and high efficiency switching for power management in portable and battery operated products.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN1 : G

PIN 2 : D

PIN 3 : S

放大及印章代码 / h_{FE} Classifications & Marking

见印章说明。See Marking Instructions.

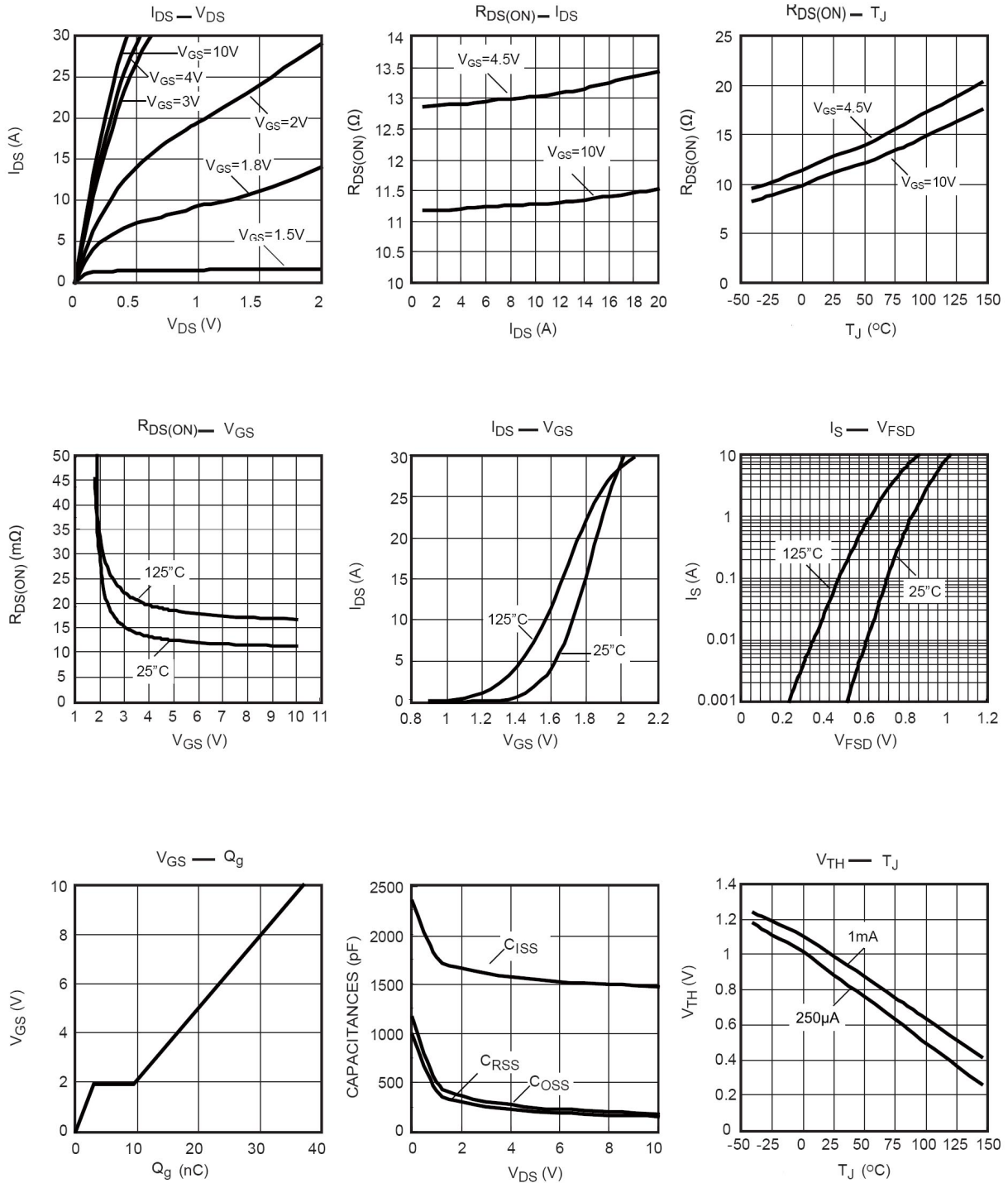

极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Drain-Source Voltage	V_{DSS}	30	V
Drain Current	$I_D(T_c=25^\circ\text{C})$	20	A
Gate-Source Voltage	V_{GS}	± 12	V
Single Pulsed Avalanche Energy	E_{AS}	180	mJ
Power Dissipation ($T_A=25^\circ\text{C}$)	$P_D(T_c=25^\circ\text{C})$	25	W
Junction Temperature Range	T_j	150	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$

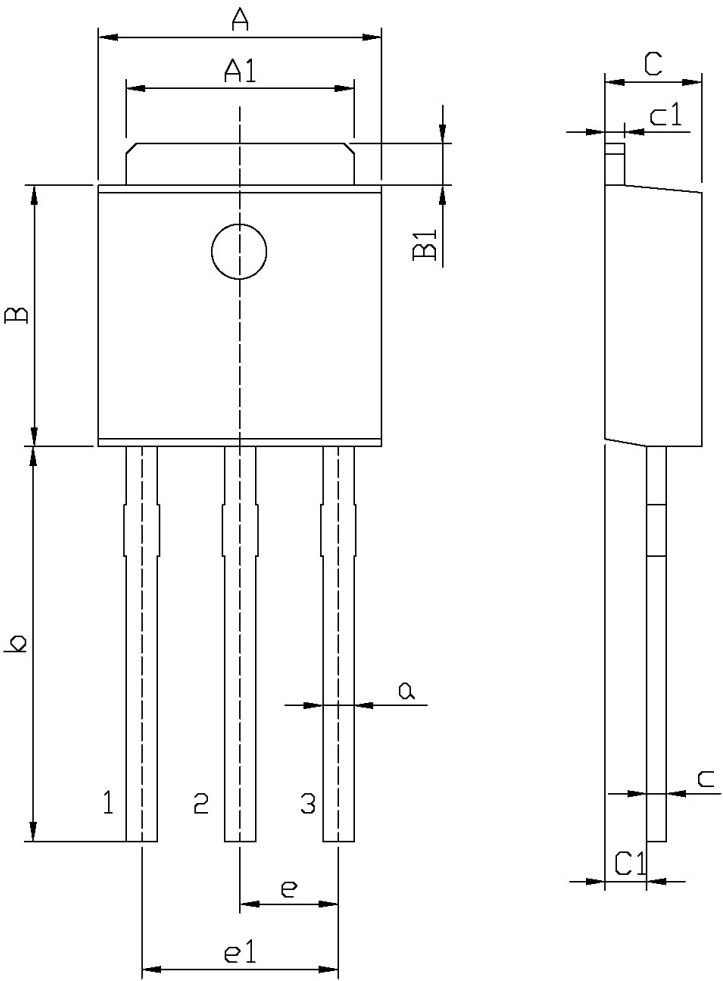
电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Drain-Source Breakdown Voltage	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V$ $I_D=250\mu A$	30			V
Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	$V_{DS}=24V$ $V_{GS}=0V$			1.0	μA
		$V_{DS}=24V$ $T_J=150^\circ\text{C}$			50	
Gate-Body Leakage Current, Forward	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 12V$ $V_{DS}=0V$			± 0.1	μA
Static Drain-Source On-Resistance	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V$ $I_D=7.0A$		11.3	13.6	$m\Omega$
		$V_{GS}=4.5V$ $I_D=7.0A$		13.4	16	$m\Omega$
		$V_{GS}=10V$ $I_D=7.0A$ $T_J=125^\circ\text{C}$		16.4		$m\Omega$
Gate Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}$ $I_D=250\mu A$	0.5	0.8	1.0	V
Drain-Source Diode Forward Voltage	V_{SD}	$V_{GS}=0V$ $I_F=7.0A$		0.7	0.9	V
Forward Transconductance	g_{FS}	$V_{DS}=5.0V$ $I_D=7.0A$		28		S
Signal Source Resistance	R_g	$F=1\text{MHz}$		1.7		Ω
Input Capacitance	C_{iss}	$V_{DS}=15V$ $V_{GS}=0V$ $f=1.0\text{MHz}$		1480		pF
Output Capacitance	C_{oss}			180		
Reverse Transfer Capacitance	C_{rss}			152		
Turn-On Delay Time	$t_{d(on)}$	$V_{DS}=15V$ $I_D=7.0A$ $R_{GEN}=3.0\Omega$ $V_{GS}=10V$		5.0		ns
Turn-On Rise Time	t_r			5.0		
Turn-Off Delay Time	$t_{d(off)}$			35		
Turn-Off Fall Time	t_f			8.0		
Total gate charge	Q_g	$V_{DS}=15V$ $I_D=7.0A$		39		nC
Gate-to-Source charge	Q_{gs}			3.0		
Gate-to-Drain charge	Q_{gd}			6.5		

电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve



外形尺寸图 / Package Dimensions

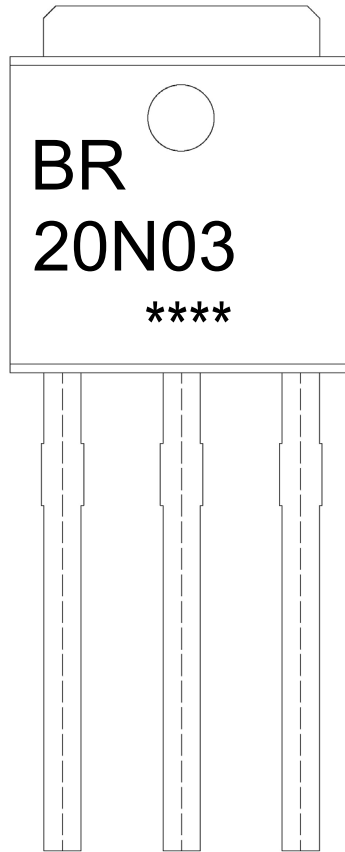


单位：mm

Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
A	6.45	6.75	a	0.50	0.70
A1	5.10	5.50	b	9.00	9.40
B	5.95	6.25	C	0.45	0.55
B1	0.95	1.25	C1	0.45	0.55
C	2.20	2.40	e	2.24	2.34
C1	0.95	1.15	e1	4.43	4.73

TO-251

印章说明 / Marking Instructions



说明：

BR： 为公司代码

20N03： 为型号代码

****： 为生产批号代码，随生产批号变化。

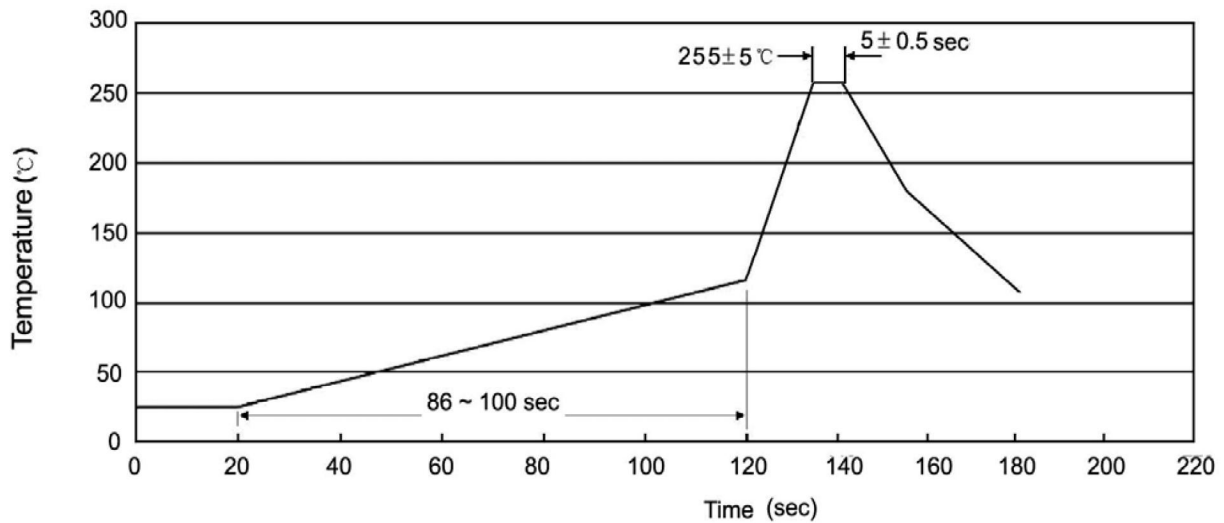
Note:

BR: Company Code

20N03: Product Type.

****: Lot No. Code, code change with Lot No.

波峰焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)



说明：

- 1、预热温度 25 ~ 150°C，时间 60 ~ 90sec;
- 2、峰值温度 255±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2 ~ 10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:255±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：270±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:270±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

散件包装 / BULK

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Bag 只/袋	Bags/Inner Box 袋/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Bag 袋	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-251	1,000	10	10,000	5	50,000	135×190	237×172×102	560×245×195

套管包装 / TUBE

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Tube 只/套管	Tubes/Inner Box 套管/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Tube 套管	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-251/252	75	48	3,600	5	18,000	526×20.5×5.25	555×164×50	575×290×180

使用说明 / Notices